

熱盤（ホットプレート）

PDFをダウンロード

熱盤はフィルムの予熱や焼成用、半導体やFPDの加熱や焼成用、プレス用等、さまざまな用途があり、ご希望の仕様に応じた熱盤を設計・製作致します。

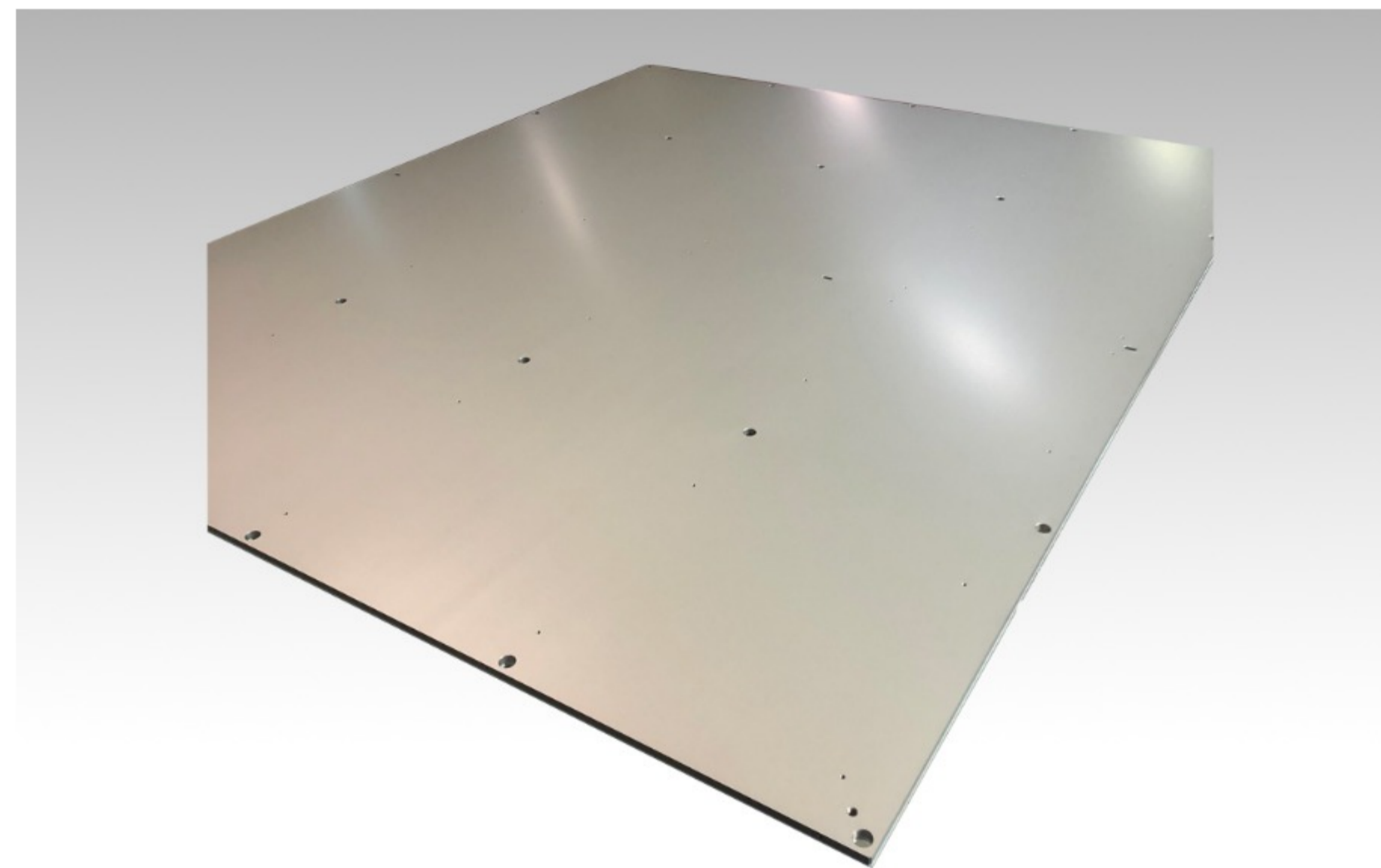
当社では様々な仕様の熱盤を設計・製作しております。自社設計・自社製作を強みとしており、お客様のご要求に応じた最適な仕様をご提案させていただきます。

- ・シーズヒーターを使用した熱盤
- ・マイクロヒーターを使用した熱盤
- ・マイカヒーターを使用した熱盤
- ・カートリッジヒーターを使用した熱盤
- ・アルミ鑄込ヒーターを使用した熱盤
- ・真鍮鑄込ヒーターを使用した熱盤
- ・ヒートパイプを使用した熱盤
- ・水冷管を使用した熱盤（冷却盤）
- ・空冷管を使用した熱盤（冷却盤）

お問い合わせ先

新日電熱工業株式会社

TEL: 0120-435-130



熱盤（ホットプレート）の特長

設計の際には、ヒーターに対するご要望や装置の仕様内容に合わせて最適なヒーター種別の選定、設計を行います。温度分布シミュレーションも自社で行っております。

まずは、お客様のご要望、仕様等をお聞かせください。

- ・被加熱物の名称、物性
- ・被加熱物のサイズ、質量
- ・加熱条件（昇温温度、昇温時間）
- ・必要な温度分布
- ・使用環境、使用圧力
- ・使用雰囲気（大気、低真空、高真空、不活性ガス等）
- ・その他要求事項

熱盤（ホットプレート）の基本仕様

材質	アルミ、ステンレス、銅、鉄、真鍮 等
形状	取付け装置、部品に合わせて自由に設計可能 丸型（外径φ300等）、角型（最大3000×3400）
表面処理	使用環境に応じて選定（アルマイト処理、各種メッキ処理）
主な用途	半導体製造工程での加熱、冷却 液晶パネル、有機ELパネル製造工程での加熱 ソーラーパネル製造工程での加熱 樹脂、プラスチック、フィルム等の成型用ホットプレス金型等